

证券代码:688802 证券简称:沐曦股份 公告编号:2026-010

## 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 关于募投项目实施周期及使用部分闲置 募集资金进行阶段性现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 募投项目实施周期,根据公司首次公开发行并上市相关规划,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)拟分一至四年投入。  
● 阶段性现金管理方案:不超过人民币29亿元(含本数),该额度是因募集资金阶段性现金管理需求,随着募投项目实施进度投入募投项目时,募集资金现金管理金额相应减少。  
● 产品特性:使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的现金管理产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。可按照募投项目资金需求随时赎回或支取,提前赎回或支取仅收一次手续费。  
● 审议时间:2026年2月3日,沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议、2026年第二次会议、第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》,保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”“华泰联合证券”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。  
● 特别风险提示:尽管公司选择低风险投资品种,满足保本要求的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整,适当介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况  
根据《沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《沐曦集成电路(上海)股份有限公司关于调整募集资金投资项目及募集资金投入金额的公告》(公告编号:2026-003),公司首次公开发行的募投项目及募集资金使用计划如下:  
单位:人民币万元

序号	项目名称	投资金额	占比	拟使用募集资金投入金额
1	新一代高性能通用GPU研发及产业化项目	340,992.38	100.00%	245,919.76
1.1	其中:新一代高性能通用GPU	156,977.30	46.03%	84,101.70
1.2	第二代高性能通用GPU	204,015.07	59.97%	161,818.06
2	新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目	57,813.35	16.62%	45,305.64
3	面向物联网及新兴应用的高性能GPU技术研发项目	102,115.42	29.91%	98,705.70
合计		500,921.15		389,931.10

(一)新一代高性能通用GPU研发及产业化项目  
1.项目进展情况  
(1)第一代高性能通用GPU芯片(C600)研发项目  
本项目投资总额为136,977.30万元,其中拟使用募集资金投入金额为84,101.70万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	项目	投资金额	占比	使用募集资金投入
1	设备购置	21,290.52	15.54%	20,000.00
2	软件购置	2,580.52	1.88%	2,000.00
3	研发费用	5,670.00	4.14%	—
4	人工工资	42,880.00	30.78%	34,040.00
5	差旅费用	27,374.39	19.98%	18,014.00
6	折旧费用	7,448.70	5.51%	5,196.60
7	租赁费用	3,023.23	2.21%	2,855.00
8	基本建设费	3,383.02	2.49%	—
9	铺底流动资金	24,360.36	17.71%	—
合计		136,977.30	100.00%	84,101.70

(2)第二代高性能通用GPU芯片(C700)研发项目  
本项目投资总额为204,015.07万元,其中拟使用募集资金投入金额为161,818.06万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	项目	投资金额	占比	使用募集资金投入
1	设备购置	23,452.50	11.50%	23,452.50
2	软件购置	7,671.56	3.76%	7,671.56
3	研发费用	8,750.00	4.29%	8,750.00
4	人工工资	60,480.00	29.64%	60,017.00
5	差旅费用	40,700.00	19.95%	40,700.00
6	折旧费用	17,527.00	8.59%	17,527.00
7	租赁费用	3,200.00	1.62%	3,200.00
8	基本建设费	4,468.43	2.39%	—
9	铺底流动资金	36,685.58	18.07%	—
合计		204,015.07	100.00%	161,818.06

2.项目周期和推进进度  
(1)第二代高性能通用GPU芯片(C600)研发项目  
本项目为公司目前在前研项目,于2024年2立项,计划建设期为3年,项目实施进度安排具体如下:

项目阶段	2024年				2025年				2026年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项												
软件购置												
产品设计与开发												
验证及测试												
小批量生产												
大规模量产												
量产后优化												

注:C600计划于2024年10月交付试产,并于2025年7月回片试产,正在进行功能测试。  
(2)第二代高性能通用GPU芯片(C700)研发项目  
本项目为公司目前在前研项目,于2025年4立项,计划建设期为3年,项目实施进度安排具体如下:

项目阶段	2025年				2026年				2027年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项												
软件购置												
产品设计与开发												
验证及测试												
小批量生产												
大规模量产												
量产后优化												

(二)新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目  
1.项目进展情况  
本项目投资总额为57,813.35万元,其中拟使用募集资金投入金额为45,305.64万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	项目	投资金额	占比	使用募集资金投入
1	设备购置	8,074.00	13.97%	8,074.00
2	软件购置	1,448.64	2.51%	1,448.64
3	研发费用	6,480.00	11.21%	6,550.00
4	人工工资	14,400.00	24.91%	14,400.00
5	差旅费用	9,540.00	16.50%	9,540.00
6	折旧费用	5,200.00	8.99%	5,200.00
7	租赁费用	1,139.17	1.97%	9,093.00
8	基本建设费	11,148.54	19.28%	—
9	铺底流动资金	57,813.35	100.00%	45,305.64

2.项目周期和推进进度  
本项目计划建设期为3年,项目实施进度安排具体如下:

项目阶段	T+1年				T+2年				T+3年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项												
软件购置												
产品设计与开发												
验证及测试												
小批量生产												
大规模量产												

(三)面向物联网及新兴应用的高性能GPU技术研发项目  
1.项目进展情况  
本项目投资总额为102,115.42万元,其中拟使用募集资金投入金额为98,705.70万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	项目	投资金额	占比	使用募集资金投入
1	设备购置	1,076.49	1.05%	1,076.49
2	软件购置	34,842.30	34.12%	34,842.30
3	研发费用	10,030.00	9.82%	10,030.00
4	软件购置	4,500.00	4.41%	4,500.00
5	人工工资	24,000.00	23.50%	23,564.52
6	差旅费用	6,000.00	5.88%	6,000.00
7	折旧费用	14,420.00	14.12%	14,420.00
8	租赁费用	4,272.80	4.18%	4,272.49
9	基本建设费	2,974.24	2.91%	—
合计		102,115.42	100.00%	98,705.70

2.项目周期和推进进度  
本项目计划建设期为4年,项目实施进度安排具体如下:

项目阶段	T+1年				T+2年				T+3年				T+4年			
	H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4
项目立项																
场地使用																
人员招聘																
软件购置																
技术研究及开发																
测试验证与推广																

(二)募集资金使用计划及募集资金投资项目情况  
根据《沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《沐曦集成电路(上海)股份有限公司关于调整募集资金投资项目及募集资金投入金额的公告》(公告编号:2026-003),公司首次公开发行的募投项目及募集资金使用计划如下:  
单位:人民币万元

序号	项目名称	投资金额	占比	拟使用募集资金投入金额
1	新一代高性能通用GPU研发及产业化项目	340,992.38	100.00%	245,919.76
1.1	其中:新一代高性能通用GPU	156,977.30	46.03%	84,101.70
1.2	第二代高性能通用GPU	204,015.07	59.97%	161,818.06
2	新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目	57,813.35	16.62%	45,305.64
3	面向物联网及新兴应用的高性能GPU技术研发项目	102,115.42	29.91%	98,705.70
合计		500,921.15		389,931.10

(一)新一代高性能通用GPU研发及产业化项目  
1.项目进展情况  
(1)第一代高性能通用GPU芯片(C600)研发项目  
本项目投资总额为136,977.30万元,其中拟使用募集资金投入金额为84,101.70万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	项目	投资金额	占比	使用募集资金投入
1	设备购置	21,290.52	15.54%	20,000.00
2	软件购置	2,580.52	1.88%	2,000.00
3	研发费用	5,670.00	4.14%	—
4	人工工资	42,880.00	30.78%	34,040.00
5	差旅费用	27,374.39	19.98%	18,014.00
6	折旧费用	7,448.70	5.51%	5,196.60
7	租赁费用	3,023.23	2.21%	2,855.00
8	基本建设费	3,383.02	2.49%	—
9	铺底流动资金	24,360.36	17.71%	—
合计		136,977.30	100.00%	84,101.70

(2)第二代高性能通用GPU芯片(C700)研发项目  
本项目投资总额为204,015.07万元,其中拟使用募集资金投入金额为161,818.06万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	项目	投资金额	占比	使用募集资金投入
1	设备购置	23,452.50	11.50%	23,452.50
2	软件购置	7,671.56	3.76%	7,671.56
3	研发费用	8,750.00	4.29%	8,750.00
4	人工工资	60,480.00	29.64%	60,017.00
5	差旅费用	40,700.00	19.95%	40,700.00
6	折旧费用	17,527.00	8.59%	17,527.00
7	租赁费用	3,200.00	1.62%	3,200.00
8	基本建设费	4,468.43	2.39%	—
9	铺底流动资金	36,685.58	18.07%	—
合计		204,015.07	100.00%	161,818.06

2.项目周期和推进进度  
(1)第二代高性能通用GPU芯片(C600)研发项目  
本项目为公司目前在前研项目,于2024年2立项,计划建设期为3年,项目实施进度安排具体如下:

项目阶段	2024年				2025年				2026年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项												
软件购置												
产品设计与开发												
验证及测试												
小批量生产												
大规模量产												
量产后优化												

注:C600计划于2024年10月交付试产,并于2025年7月回片试产,正在进行功能测试。  
(2)第二代高性能通用GPU芯片(C700)研发项目  
本项目为公司目前在前研项目,于2025年4立项,计划建设期为3年,项目实施进度安排具体如下:

项目阶段	2025年				2026年				2027年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项												
软件购置												
产品设计与开发												
验证及测试												
小批量生产												
大规模量产												
量产后优化												

(二)新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目  
1.项目进展情况  
本项目投资总额为57,813.35万元,其中拟使用募集资金投入金额为45,305.64万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	项目	投资金额	占比	使用募集资金投入
1	设备购置	8,074.00	13.97%	8,074.00
2	软件购置	1,448.64	2.51%	1,448.64
3	研发费用	6,480.00	11.21%	6,550.00
4	人工工资	14,400.00	24.91%	14,400.00
5	差旅费用	9,540.00	16.50%	9,540.00
6	折旧费用	5,200.00	8.99%	5,200.00
7	租赁费用	1,139.17	1.97%	9,093.00
8	基本建设费	11,148.54	19.28%	—
9	铺底流动资金	57,813.35	100.00%	45,305.64

2.项目周期和推进进度  
本项目计划建设期为3年,项目实施进度安排具体如下:

项目阶段	T+1年				T+2年				T+3年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项												
软件购置												
产品设计与开发												
验证及测试												
小批量生产												
大规模量产												

(三)面向物联网及新兴应用的高性能GPU技术研发项目  
1.项目进展情况  
本项目投资总额为102,115.42万元,其中拟使用募集资金投入金额为98,705.70万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

序号	项目	投资金额	占比	使用募集资金投入
1	设备购置	1,076.49	1.05%	1,076.49
2	软件购置	34,842.30	34.12%	34,842.30
3	研发费用	10,030.00	9.82%	10,030.00
4	软件购置	4,500.00	4.41%	4,500.00
5	人工工资	24,000.00	23.50%	23,564.52
6	差旅费用	6,000.00	5.88%	6,000.00
7	折旧费用	14,420.00	14.12%	14,420.00
8	租赁费用	4,272.80	4.18%	4,272.49
9	基本建设费	2,974.24	2.91%	—
合计		102,115.42	100.00%	98,705.70

2.项目周期和推进进度  
本项目计划建设期为4年,项目实施进度安排具体如下:

项目阶段	T+1年				T+2年				T+3年				T+4年			
	H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4
项目立项																
场地使用																
人员招聘																
软件购置																
技术研究及开发																
测试验证与推广					</											